附件

《广州市南沙区半导体和集成电路产业发展规划（2023-2027年）

（征求意见稿）》公众意见采纳情况汇总表

意见征集期间共收到反馈意见4条，已进行研究，具体采纳情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **来信人** | **意见** | **意见采纳情况** | **采纳/未采纳理由** |
| 广东芯粤能半导体有限公司 | 第36页第17行，增加:针对南沙区重点发展第三代半导体产业的宏观任务，大力引进第三代半导体专用设备厂商入驻或设点提供专业服务。 | 采纳 | 建议合理，已采纳 |
| 广州南砂晶圆半导体技术有限公司 | 1.58页的第6段第3-6 行“南砂晶圆产品主要以6寸兼容4寸的全导电衬底片、高纯半绝缘衬底片和高纯半绝缘外延片为主。此项目稳定运营后将年产各类衬底片和外延片共 20 万片”建议修改为“南砂晶圆产品主要以6 英寸、8英寸的导电型衬底片、半绝缘型衬底片为主。此项目稳定运营后将年产各类衬底片共20万片”  2.58 页的第8段第2-3 行“目前主要产品为4英寸衬底片，目前已通过车规级认证，6英寸产品已具备量产技术”建议修改为“目前主要产品为6 英寸衬底片，目前已通过车规级认证，8 英寸产品已具备量产技术”  3.建议94页第1行“重点招引项目”之后增加“引进一些衬底上游企业:包括关键装备(激光切割、研磨抛光设备等) 和原材料(石墨材料、保温材料)企业。 | 采纳 | 建议合理，已采纳 |